

高等学校试用教材

# 电工学基本教程

孙骆生 主编

DIANGONGXUE

JIBEN

JIAOCHENG

下

高等 教育 出 版 社

## 内 容 提 要

本书是根据 1980 年 6 月制定的高等工业学校 120 学时类型《电工学教学大纲(草案)》编写的，经过高等学校工科电工教材编审委员会电工学教材编审小组评选，作为高等工业学校非电专业 120 学时类型电工学课程的基本教材。

本书分上、下册出版。下册包括二极管和整流电路、晶体管和交流放大电路、晶体管振荡器、晶体管直流放大电路、晶闸管及其应用，书后附有常用电子器件型号和参数的附表。每章均穿插有例题、思考题，并附有小结、习题和部分习题答案。

高等学校试用教材  
**电工学基本教程**

下 册  
孙骆生 主编

\*  
高等教育出版社出版  
新华书店北京发行所发行  
河北省香河县印刷厂印装

\*  
开本 850×1168 1/32 印张 7.25 字数 175,000  
1984 年 4 月第 1 版 1984 年 10 月第 1 次印刷  
印数 00,001~ 27,000  
书号 15010·0570 定价 1.10 元

# 目 录

<b>第九章 二极管和整流电路</b> .....	1
9-1 半导体的导电方式.....	1
9-2 PN 结及其单向导电性.....	4
9-3 半导体二极管的伏安特性和主要参数.....	7
9-4 单相桥式整流电路.....	11
<sup>△</sup> 9-5 三相整流电路.....	15
9-6 滤波电路.....	18
一、电容滤波.....	19
二、电感滤波.....	22
三、电感电容(LC)和电阻电容(RC)滤波器.....	23
四、II型滤波器.....	26
9-7 硅稳压管和简单稳压电路.....	26
一、硅稳压管.....	27
二、硅稳压管稳压电路.....	29
本章小结.....	30
习题.....	31
<b>第十章 晶体管和交流放大电路</b> .....	34
10-1 晶体管.....	35
一、晶体管的外形、结构和命名.....	35
二、晶体管的电流放大作用.....	37
三、晶体管的特性.....	41
四、晶体管的主要参数.....	45
10-2 交流放大电路的基本工作原理.....	49
一、单管交流放大器的组成及各元件的作用.....	49
二、固定偏置放大电路的工作状态.....	52
三、放大器的交流通路和直流通路.....	57
10-3 交流放大电路的图解法及其应用.....	60
一、静态工作点的图解.....	60

二、动态工作情况的图解 .....	62
三、非线性失真的图解和静态工作点的选择 .....	65
<b>10-4 晶体管和放大器的小信号模型.....</b>	<b>70</b>
一、晶体管的简化小信号模型 .....	70
二、单管放大器的简化小信号模型 .....	72
三、放大器的输入电阻和输出电阻 .....	73
<b>10-5 静态工作点的稳定.....</b>	<b>76</b>
一、温度对静态工作点的影响 .....	76
二、分压式电流负反馈偏置电路 .....	77
<b>10-6 多级电压放大器.....</b>	<b>80</b>
一、电路的联接 .....	81
二、电压放大倍数 .....	82
<b>10-7 阻容耦合放大器的频率特性.....</b>	<b>84</b>
一、频率特性和失真 .....	84
二、低频特性 .....	86
三、高频特性 .....	87
<b>10-8 放大器中的负反馈.....</b>	<b>88</b>
一、放大器中负反馈的基本类型 .....	88
二、常用的负反馈放大电路 .....	93
三、负反馈对放大器性能的影响 .....	100
<b>10-9 功率放大器.....</b>	<b>103</b>
一、无输出变压器的功率放大器 .....	104
<sup>△</sup> 二、变压器耦合推挽功率放大器 .....	114
<b>本章小结.....</b>	<b>118</b>
<b>习题.....</b>	<b>120</b>
<b>第十一章 晶体管振荡器.....</b>	<b>127</b>
<b>11-1 自激振荡器的基本工作原理.....</b>	<b>127</b>
一、自激振荡现象 .....	127
二、自激振荡条件 .....	129
<b>11-2 LC 振荡器.....</b>	<b>131</b>
一、LC 振荡电路及其选频特性 .....	131
二、变压器反馈 LC 振荡器 .....	135
三、自激振荡的建立和振幅的稳定 .....	137

---

11-3 RC 振荡器.....	138
一、RC 串并联网络的选频特性 .....	139
二、桥式 RC 振荡器.....	141
本章小结.....	143
习题.....	143
<b>第十二章 晶体管直流放大电路.....</b>	<b>145</b>
12-1 单端式直接耦合放大电路.....	145
一、静态工作点的设置 .....	146
二、电压放大倍数 .....	147
三、零点漂移 .....	148
12-2 差动式放大电路.....	150
一、基本电路 .....	150
二、具有射极电阻的差动式放大电路 .....	153
三、差动放大电路的几种接法 .....	155
<sup>4</sup> 四、具有恒流源的差动式放大电路 .....	160
12-3 运算放大器和线性集成放大电路.....	161
一、线性集成放大电路简介 .....	162
二、运算放大器的基本联接方式 .....	165
12-4 运算放大器的应用.....	170
一、比例运算 .....	170
二、加、减运算 .....	170
三、积分运算 .....	172
四、电压-电流和电流-电压转换器 .....	173
五、比较器 .....	174
本章小结.....	176
习题.....	177
<b>第十三章 晶闸管及其应用.....</b>	<b>181</b>
13-1 晶闸管的结构、特性和参数 .....	182
一、晶闸管的结构和可控单向导电特性 .....	182
二、晶闸管的伏安特性 .....	184
三、晶闸管的参数 .....	186
13-2 单相半波可控整流电路.....	188
一、带电阻负载的电路 .....	188

## 目 录

---

二、带电感性负载的电路 .....	191
13-3 单相半控桥式整流电路.....	194
13-4 晶闸管的保护.....	198
一、晶闸管的过电流保护 .....	198
二、晶闸管的过电压保护 .....	199
13-5 单结晶体管触发电路.....	200
一、单结晶体管的结构和特性 .....	200
二、单结晶体管的自振荡电路 .....	203
三、可控整流的单结晶体管触发电路 .....	204
本章小结.....	206
习题.....	207
<b>附表一 常用半导体二极管的型号和主要参数.....</b>	<b>209</b>
<b>附表二 常用晶体管的型号和主要参数.....</b>	<b>214</b>
<b>附表三 普通晶闸管的参数及各种单相可控整流电路的 比较.....</b>	<b>221</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>225</b>

## 第九章 二极管和整流电路

通常，电力网供给的是交流电，而在工业生产、交通运输和科学实验中，却常常要用直流电。这就需要把交流电变换为直流电。本章讲的就是用来实现这种变换的整流电路。

整流电路中必需有整流元件，以前主要用电子管和离子管，从六十年代起已广泛采用半导体二极管。

半导体二极管所以能用作整流元件，关键在于管子内部的PN结具有单向导电性。有关半导体的理论，物理学中作过介绍，本章只作扼要复习，而主要讲述半导体二极管的伏安特性和参数，以及整流电路的分析计算，最后还要简略介绍稳压管及简单稳压电路。

### 9-1 半导体的导电方式

常用的半导体，例如硅和锗，属于四价元素，即其原子的最外层轨道上有四个价电子。硅和锗的单晶体，原子排列非常整齐，且每个原子的四个价电子各为相邻的四个原子所分别共有，如图9-1所示。原子间的这种结合叫做共价键结构。温度为绝对零度时，共价键中的电子被束缚得很紧，这种情况下的半导体几乎相当于绝缘体。在一般情况下，硅单晶体（或锗单晶体）受室温作用或光的照射，共价键中的束缚电子，有的吸收一定能量而冲破键的束缚，成为自由电子，这个过程叫做激发。被冲破的键，失去一个电子，就在键中出现一个电子的空位，通常把它叫做空穴，如图9-2所示。空穴既然是共价键失去电子的结果，自然呈正电性。一个

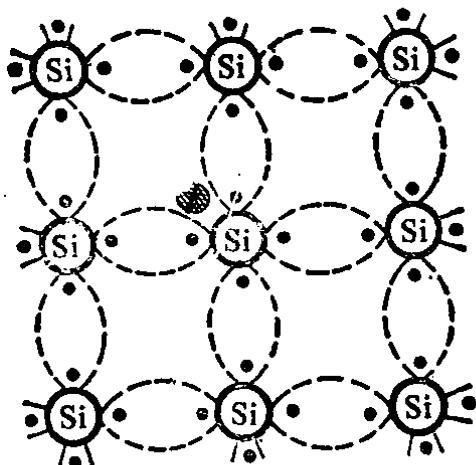


图 9-1 硅原子间的共价键结构

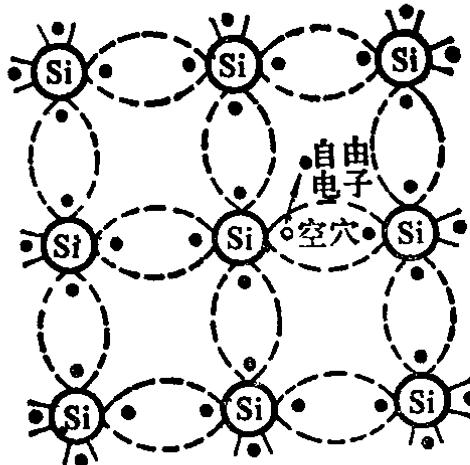


图 9-2 由激发产生的自由电子和空穴

共价键中出现的空穴，很容易被附近另一共价键中的电子移过来填充，从而又在移出电子的键中出现空穴，如此连续进行，表现为空穴的移动，即相当于正电荷的移动。如有外电场作用，由激发产生的自由电子将逆着电场方向运动，而空穴则顺着电场方向连续移动，前者形成电子电流，后者形成空穴电流，二者方向相反，所带电荷符号也相反，但电流效应相同。可见，半导体中的电流是电子流和空穴流的总和。电子和空穴统称为半导体中的载流子。

在半导体中，自由电子如果同空穴相遇，可能放出吸收的能量而填充到空穴中去，这个过程叫做复合。每一次复合，都有一个自由电子和一个空穴同时消失。而且，激发和复合总是在半导体中不断地进行。所以，在一定环境下，半导体中的载流子数目基本上一定。

在结构完整和高度纯净的半导体中，电子和空穴总是成对出现，彼此数目完全相等，两种载流子同时产生，又同时参加导电，这样的半导体叫做本征半导体。

在室温条件下，本征半导体的载流子数量很少，其导电性能远比导体差。

如在纯净的硅中掺入微量三价元素硼（或铝、铟等），在硼原子

(B) 同周围四个硅原子(Si)组成的共价键结构中, 因硼原子只有三个价电子而出现空穴(图 9-3), 从而使空穴的数目相应增加, 自由电子的数目仍然极少。这种半导体主要靠空穴导电, 叫做空穴型半导体, 又称 P 型半导体。换句话说, P 型半导体中的多数载流子为空穴。应当指出, 因掺入三价元素而引起空穴数目的增加, 并不使半导体带电, 即半导体对外仍呈电中性。

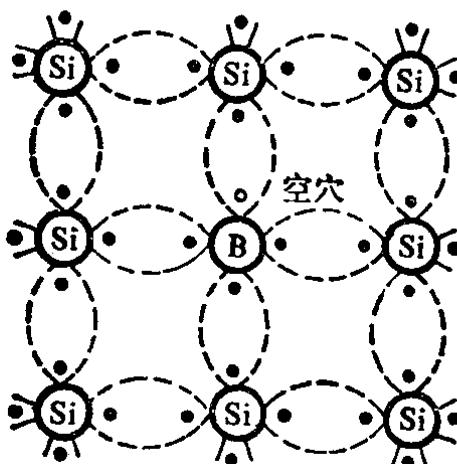


图 9-3 硅单晶体中掺入硼(B)元  
素形成空穴

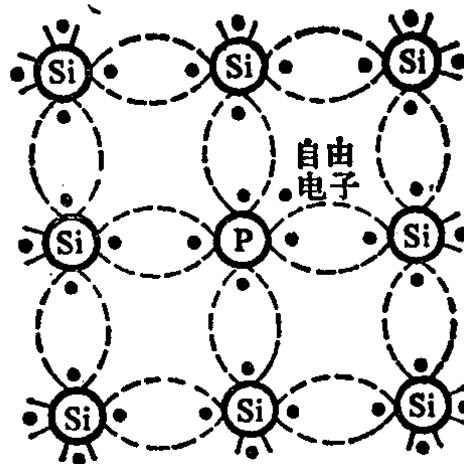


图 9-4 硅单晶体中掺入磷(P)元素  
提供自由电子

如果在硅的单晶体中掺入微量的五价元素磷(或锑), 则在磷原子(P)同周围四个硅原子组成的共价键结构中, 因磷原子有五个价电子而多出一个电子(图 9-4), 从而使自由电子的数目相应增加, 空穴仍然极少。这种半导体主要靠电子导电, 或者说, 它的多数载流子为电子, 故叫做电子型半导体, 又叫做 N 型半导体。同样, 自由电子数目的增加, 并不改变半导体的电中性。

上述两种掺杂半导体的多数载流子浓度, 基本上取决于掺杂浓度, 而少数载流子浓度则随着温度的升高而增大。

**思考题 9-1** 在半导体中, 空穴的移动实质上也是电子的移动。那末, 它和自由电子的移动有何区别?

## 9-2 PN 结及其单向导电性

如果采取某种措施在同一块半导体上形成 P 型区和 N 型区两部分，就构成了所谓的 PN 结。

制造 PN 结的方法，常用的有扩散法和合金法，而前者用得较多。用扩散法制造平面型 PN 结的工艺过程大致如图 9-5 所示，先用氧化法在 N 型硅片的表面生成一层二氧化硅薄膜，如图(a)。再用光刻法在二氧化硅薄膜上开出一个“窗口”，如图(b)，然后通过窗口对 N 型硅片进行高浓度的硼扩散，如图(c)，就能使靠近窗口的部分获得足够的硼原子而转化为 P 型硅，如图(d)。适当控制扩散温度和扩散时间，此 P 型区将有合适的杂质浓度和深度。

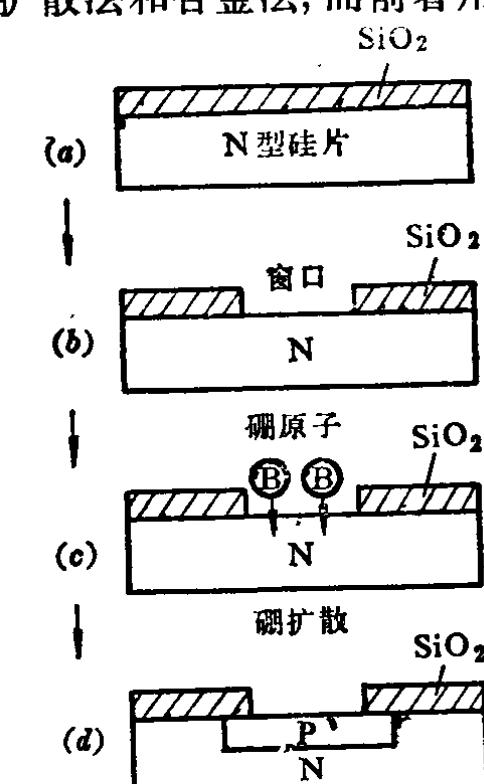


图 9-5 用扩散法制造 PN 结的过程示意

由于 P 区空穴浓度高，N 区却几乎没有空穴，P 区的空穴就要穿过 P 区和 N 区的交界面向 N 区扩散。同样，因 P 区电子浓度远低于 N 区，N 区的电子也要向 P 区扩散。随着扩散的进行，在交界面附近，P 区的空穴和 N 区的电子都将消失。前面曾经指出，无论是 P 型半导体还是 N 型半导体都是电中性的，如图 9-6 (a) 所示。现在，由于相互扩散的结果，交界面两侧将分别出现带电荷的薄层，如图 9-6 (b) 所示。P 区的薄层带负电，N 区的薄层带正电，统称为空间电荷区。在这个区域内，电子和空穴都已复合，基本上没有载流子，有的只是不能移动的负离子和正离子，在

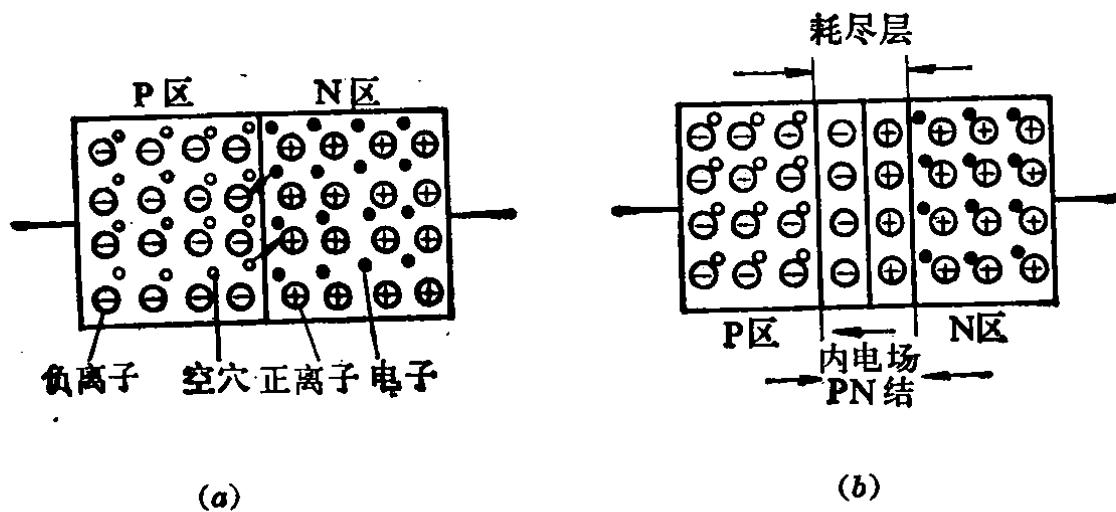


图 9-6 PN 结的形成

P 区是获得了电子的三价杂质原子，在 N 区是失去了电子的五价杂质原子，它们都处在半导体的晶格结构中，都是不能移动的。所以，空间电荷区有很高的电阻率，故又叫做阻挡层，或叫做耗尽层（载流子耗尽了）。

随着交界面两侧正、负电荷层的出现，同时形成一个电场，叫做内电场或自建电场，其方向为从 N 区指向 P 区，如图 9-6(b)所示。这个自建电场，既阻碍 P 区的空穴向 N 区扩散，又阻碍 N 区的电子向 P 区扩散。或者说，自建电场要使两种载流子分别向着与前述扩散方向相反的方向运动。载流子在电场作用下的运动叫做漂移运动。PN 结没有外加电压时，其中的扩散运动和漂移运动处于动平衡状态，总的看来，没有载流子越过 PN 结。

实际工作中的半导体器件，PN 结上总有外加电压。由于外加电压的方向不同，PN 结的情况也有明显的不同。

PN 结加正向电压的情况，如图 9-7(a)所示。直流电源正极接 P 区，负极接 N 区，外加电压在 PN 结上形成外加电场，其方向从 P 区指向 N 区，恰好与自建电场方向相反，削弱了自建电场，打破了 PN 结中的动平衡状态，载流子的扩散运动超过了漂移运动。于是，P 区和 N 区的多数载流子又能越过 PN 结向对方扩散。从

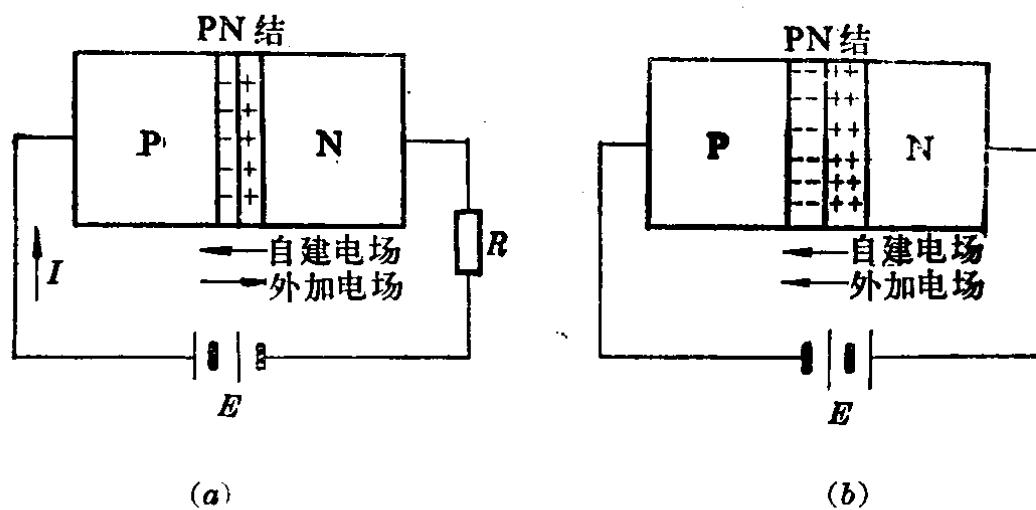


图 9-7 外加电压对 PN 结的影响

N 区注入到 P 区的电子，在扩散过程中先后同 P 区的空穴复合，外加电源正极则不断给 P 区补充空穴（实际是拉走共价键中的电子，从而留下空穴）；同样，从 P 区注入到 N 区的空穴，也先后同 N 区的电子复合，电源负极则不断给 N 区补充电子。可见，在给 PN 结加正向电压情况下，整个电路中有载流子的连续和定向的移动，即形成了电流。此电流通过 PN 结的方向为从 P 区到 N 区，叫做正向电流。

PN 结加反向电压的情况，如图 9-7(b) 所示。直流电源负极接 P 区，正极接 N 区，在 PN 结上的外加电场方向与自建电场方向相同，使空间电荷区电场强度增强，即正、负电荷量加大。由于空间电荷区的电荷密度是由杂质浓度决定的，不随外加电压变化，因此，空间电荷量的加大，将表现为空间电荷区的加宽。于是，P 区的空穴和 N 区的电子更难以越过 PN 结而向对方扩散，只有少数载流子（P 区的电子和 N 区的空穴）在外加电场作用下越过 PN 结，形成从 N 区流向 P 区的电流，叫做反向电流。由于少数载流子数量极微，故反向电流很小，可以看成 PN 结反向不导通。

上述情况表明，PN 结具有单向导电性，导电方向从 P 区到 N 区。导电条件是加正向电压。

PN 结加反向电压时, 空间电荷区电场强度增强, 正、负电荷量加大, PN 结加宽。所加反向电压越高, 交界面两侧的正、负电荷量越大; 反向电压降低, 正、负电荷量则随之减小, 即 PN 结上反向电压改变  $\Delta U$  时, 空间电荷区的电荷量将随之改变  $\Delta Q$ , 这说明 PN 结空间电荷区有电容效应, 称为结电容, 其电容量为  $C_j = \frac{\Delta Q}{\Delta U}$ , 具有非线性的性质。利用结电容的非线性, 可制成变容二极管。对其它一些 PN 结器件, 如晶体三极管, 结电容会给它的高频特性和开关特性带来不良影响。

### 9-3 半导体二极管的伏安特性和主要参数

半导体二极管的外形因型号和规格的不同而有所不同, 图 9-8 所示是常见的几种。由图可见, 不管二极管的外形如何, 都有

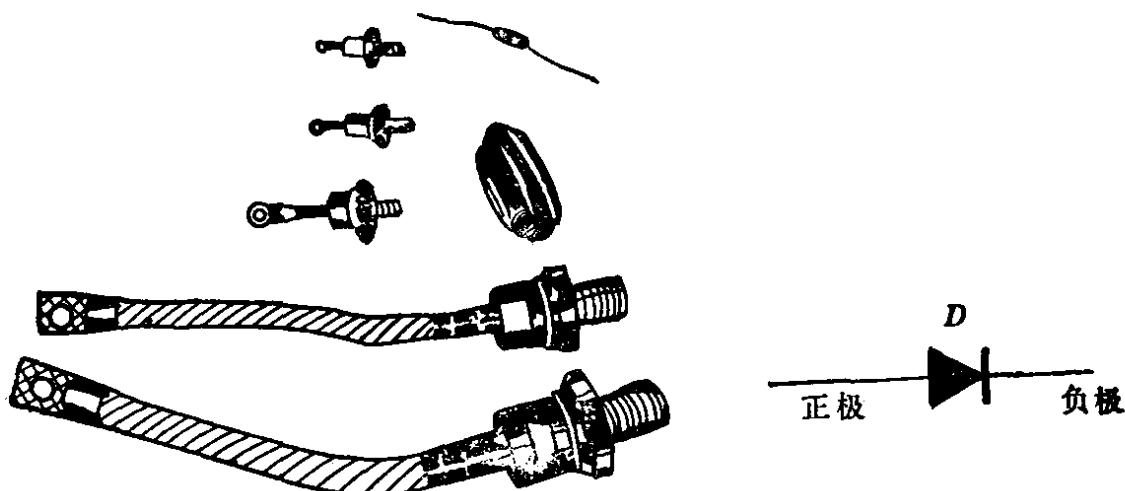


图 9-8 几种半导体二极管的外形

图 9-9 二极管的符号

两个电极, 一为正极(又叫阳极), 一为负极(又叫阴极)。在电路图中, 二极管的图形符号如图 9-9 所示, 文字符号用 D 表示。

半导体二极管的结构, 就是一个 PN 结加上电极引线和管壳, 正极从 P 区引出, 负极从 N 区引出, 故它的导电方向是从正极指

向负极。按照 PN 结的构成方式，可将半导体二极管分成点接触型、面结合型和平面型三类，图 9-10 所示是平面型二极管的内部结构。

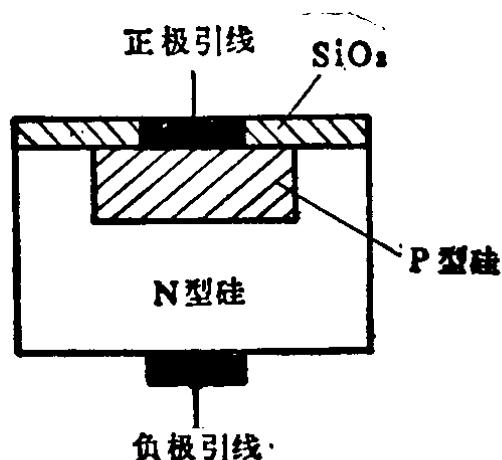


图 9-10 平面型二极管的内部结构

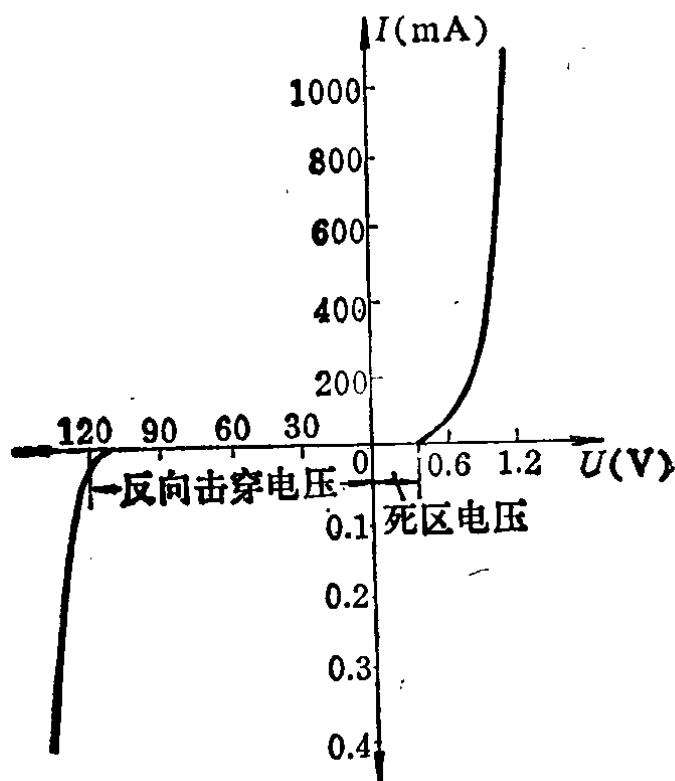


图 9-11 硅二极管伏安特性举例

和一般电路器件特性的表示方法相似，半导体二极管的外部特性，也用二极管两端的电压和二极管中电流的对应关系曲线来表示，称为二极管的伏安特性。各种二极管的伏安特性都可以根据实验数据绘成，也可以从一般半导体器件手册上查到。图 9-11 所示是硅二极管伏安特性的一个具体例子。型号不同的二极管，参数不尽相同，但伏安特性的形状却大致相似。

图 9-11 表明，二极管的伏安特性曲线由正向特性(在第一象限)和反向特性(在第三象限)两部分组成。

正向特性表明，当二极管的正向电压很小时，流过它的正向电流也很小；当正向电压稍为增大(硅管超过 0.5V，锗管超过 0.1V，即所谓死区电压)时，正向电流开始增大。对一定型号的半导体二极管，允许通过的正向电流平均值  $I_A$  有一定限制，这个允许值叫

做二极管的最大整流电流，它是一个重要参数。在最大整流电流范围内，管子正向压降都不大（表 9-2），或者说，二极管的正向电阻很小。以后在讨论二极管整流电路时，常将管子的正向压降忽略不计。

反向特性表明，二极管的反向电压小于某一数值时，反向电流很小（即二极管的反向电阻很大），它是由激发所生少数载流子形成的，在一定温度下是个常数，不随外加反向电压的大小而变化，通常称为反向漏电流或反向饱和电流。前面曾经指出，半导体中少数载流子的浓度与温度有关，故半导体二极管反向漏电流的大小也与环境温度有关，它随着温度的升高而剧烈增加。以硅二极管为例，如果设它在室温为 25°C 时的反向漏电流等于 1 个单位，则随着室温的升高，其增长情况如表 9-1 所示。

硅二极管的反向电流随环境温度增长的情况

表 9-1

环境温度	25°C	55°C	95°C	140°C
反向电流	1	10	100	1000

值得注意的是，即使在室温条件下，若二极管的反向电压大于某一定值，反向电流也会急剧增大，这种现象叫做反向击穿，该一定值叫做二极管的反向击穿电压。一般半导体器件手册上给出的各种二极管的最高反向工作电压  $U_{PR}$ ，就是按其反向击穿电压的 1/2 或 2/3 规定的，这是它的又一个重要参数。在使用二极管时，一般要注意加给它的反向电压最大值应小于它的  $U_{PR}$  值。

不同型号的半导体二极管有不同的参数值，表 9-2 仅举几例常用的半导体二极管。其中，型号的第一位是数字，2 是二极管的代号；第二位是文字，A 表示管心用 N 型锗作基片，C 表示用 N 型硅作基片；第三位也是文字，表示管子的用途，P 代表普通管，Z 代表整流管；最后一位数字（和文字）是管子序号，详见 36 页表 10-1。

常用半导体二极管主要参数举例

表 9-2

型 号	最大整流电流 (mA)	最高反向工作电压 (峰 值) (V)	反向击穿电压 (V)	最高工作频率 (MHz)	最大整流电流下的正向压降 (V)	最高反向工作电压下的反向电流 (μA)
2AP3	25	30	≥45	150	<1	≤250
2AP6	12	100	≥150	150	<1	≤250
2CP10	100	25			≤1.5	≤5
2CP33H	500	400			≤1	≤300
2CZ11A	1000	100			≤1	≤0.6×10 <sup>3</sup>
2CZ14F	10×10 <sup>3</sup>	600			≤0.8	≤6×10 <sup>3</sup>

思考题 9-2 用一节 1.5 V 的干电池和一个小电珠串联，可作为测定半导体二极管好坏和判别其正、负极的装置。试说明其原理和测试方法。

思考题 9-3 实际上，常用万用表的欧姆(Ω)挡来测定半导体二极管的好坏和极性，如图 9-12 所示。其中，(a)、(b)两图的差别在于：二极管的正、负极同万用表的红、黑表笔的联接对调了位置，且图(a)显示的电阻小(几百欧)，图(b)显示的电阻大(几百千欧)。试指出二极管的好坏和它的正、负极，并说明理由。(提示：万用表端钮上标的“+”、“-”代表万用表测量电流的入端和出端恰好“+”端同其内部电池的负极相联“-”端同电池的正极相联。)

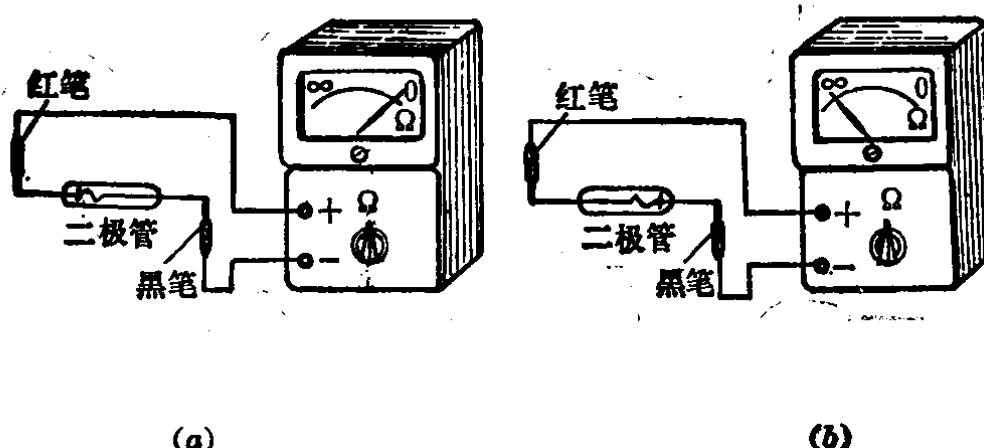


图 9-12 用万用表欧姆挡检测二极管

## 9-4 单相桥式整流电路

利用二极管组成的整流电路，按所接交流电源的相数分，主要有单相整流电路和三相整流电路两大类。而单相整流电路，按联接方式或整流电压的波形分，又可分为半波、全波和桥式等几种。本节只介绍应用最为广泛的单相桥式整流电路。它的电路原理图，如图 9-13(a) 所示。在一些电子仪器的电路图中，为简便起见，常将单相桥式整流电路画成图 9-13(b) 的形式。

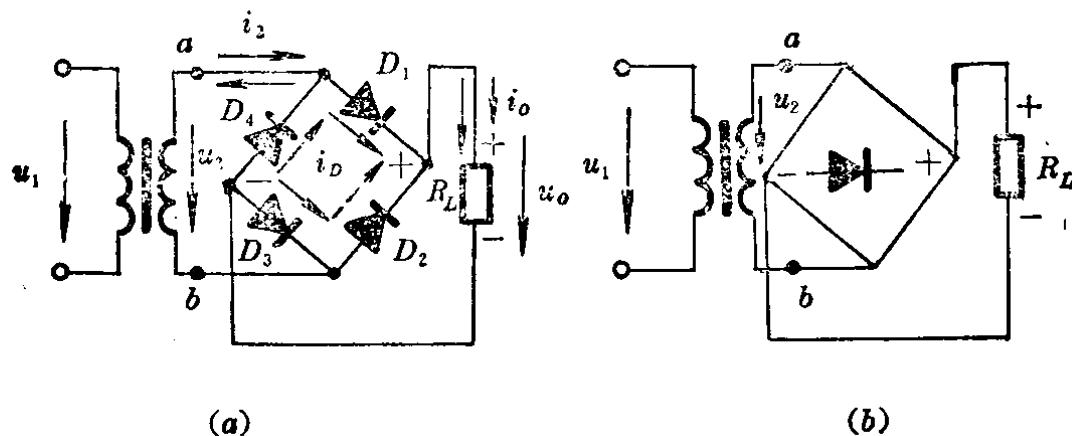


图 9-13 单相桥式整流电路

这种整流电路的工作原理如下：

$$\text{设变压器副边电压有效值为 } U_2, \text{ 瞬时值 } u_2 = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t \quad (9-1)$$

在  $u_2$  的正半周，二极管  $D_1$  和  $D_3$  因受正向电压作用而导通，电流方向如图 9-13(a) 中实线箭头所示，即从变压器  $a$  端流出，经  $D_1$ 、 $R_L$  和  $D_3$  后，到  $b$  端流入变压器。忽略  $D_1$  和  $D_3$  的正向压降，可认为输出给负载的电压为  $u_o = u_2$ 。此时， $D_2$  和  $D_4$  均受反向电压作用而截止。反向电压的大小近似等于  $u_2$ ，其最大值为  $\sqrt{2} U_2$ ，即

$$U_{RM} = \sqrt{2} U_2 \quad (9-2)$$